07

2

Исследование градиента состава слоев GalnAsP, полученных на InP методом газофазной эпитаксии

© В.И. Васильев¹, Г.С. Гагис^{1,¶}, Р.В. Левин¹, А.Е. Маричев¹, Б.В. Пушный¹, М.П. Щеглов¹, В.И. Кучинский^{1,2}, Б.Я. Бер¹, Д.Ю. Казанцев¹, А.Н. Горохов¹, Т.Б. Попова¹

 1 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

² Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия

[¶]E-mail: galina.gagis@gmail.com

Поступило в Редакцию 28 июня 2018 г.

Для твердых растворов Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y} (x = 0.86, y = 0.07-0.42), полученных на InP методом газфазной эпитаксии из металлоорганических соединений при пониженном давлении, выявлено плавное изменение содержания компонентов пятой группы y по толщине эпитаксиального слоя (600-850 nm) на величину Δy до 0.08, хотя состав газовой смеси, температура и давление в процессе роста поддерживались неизменными. Для разных составов газовой смеси величина Δy и характер ее изменения были различными. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что величина Δy связана с деформациями, возникающими в растущем слое за счет рассогласования с подложкой.

DOI: 10.21883/PJTF.2018.24.47025.17442

Ввиду предпочтения, отдаваемого безалюминиевым технологиям, твердые растворы GaInAsP являются привлекательными материалами для фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в системах беспроводной передачи энергии, включающих также твердотельный Nd: YAG-лазер с рабочей длиной волны 1064 nm (1.165 eV). Активная область ФЭП под такое излучение должна иметь ширину запрещенной зоны $E_g = 1.05 - 1.15$ eV. На рис. 1 приведены расчеты с использованием параметров из работы [1]. Можно видеть, что подходящие составы

17

твердых растворов $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ лежат в области x = 0.79 - 0.87, y = 0.3 - 0.46.

Для получения эпитаксиальных слоев A³B⁵ в настоящее время широко применяется метод газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (ГФЭМОС). Получение твердых растворов GaInAsP на подложках InP главным образом связано с изготовлением лазеров на длины волн $1.2-1.6\,\mu m$ [2], где используются $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ с составами у > 0.46. Что касается диапазона составов с у < 0.46, то в нем получены твердые растворы Ga_{0 11}In_{0 89}As_{0 24}P_{0 76} с толщинами до 100 nm для лазерной структуры [3]. Для активных областей ФЭП требуются более толстые слои (от 500 nm) высокого кристаллического совершенства, которое может быть достигнуто при достаточной степени однородности слоя по составу. Согласно данным работы [4], при у < 0.44 наблюдаются неоднородности в содержании компонентов пятой группы в GaInAsP по площади структуры. Изучению однородности по толщине эпитаксиальных слоев GaInAsP практически не уделяется внимания. Тем не менее, как показали исследования систем твердых растворов InAsPSb, полученных методом ГФЭМОС на InAs, содержание элементов пятой группы может изменяться по толщине эпитаксиального слоя [5-7]. В [5,6] эпитаксиальные слои InAsPSb были выращены при атмосферном давлении, неоднородности объяснялись характером поступления газовых смесей в реактор. Согласно нашим исследованиям слоев InAsPSb, полученных методом ГФЭМОС при пониженном давлении [7], достаточно ощутимую роль в возникновении градиента содержания элементов пятой группы по толщине играет несоответствие параметра решетки между растущим слоем и подложкой, которое в свою очередь зависит от состава газовой смеси.

В настоящей работе методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) обнаружены неоднородности распределения компонентов пятой группы по толщине в эпитаксиальных слоях $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ с составами $x = 0.86 \pm 0.02$, y = 0.2-0.4.

Эпитаксиальные слои GaInAsP были получены на подложках InP(001):Sn с уровнем легирования $n = (1-3) \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, разориентированных на 4°. Эпитаксиальный рост осуществлялся на установке AIX200 фирмы AIXTRON при температуре 600°C и давлении 0.1 atm. В качестве газа-носителя применялся водород, общий поток водорода через реактор составлял 5 L/min. В качестве прекурсоров

элементов третьей группы использовались триэтилгаллий (TEGa) и триметилиндий (TMIn), находящиеся при температуре 17°С, в качестве прекурсоров элементов пятой группы — арсин (AsH₃) и фосфин (РН₃). В процессе нагрева реактора, после достижения температуры выше 400°С, в реактор подавался фосфин с целью предотвращения десорбции фосфора поверхностью подложки InP. Перед получением эпитаксиальных слоев GaInAsP выращивались буферные слои InP с толщинами 160-320 nm при отношении суммарных потоков прекурсоров пятой и третьей групп V/III = 305, поток TMIn составлял $X_{\text{TMIn}} = 25.64 \,\mu \text{mol/min}$. После получения буферного слоя в течение одной минуты через реактор продувался чистый водород для полной замены газовой смеси, после чего в течение 60 min подавалась газовая смесь для выращивания GaInAsP. Потоки TMIn, TEGa для всех рассмотренных в настоящей работе образцов составляли $X_{\text{TMIn}} = 18 \,\mu \text{mol/min}$, $X_{\text{TEGa}} = 20 \,\mu\text{mol/min}$, потоки арсина $X_{\text{AsH}_3} = 16-31 \,\mu\text{mol/min}$, фосфина $X_{\rm PH_3} = 848 - 1696 \,\mu {\rm mol/min.}$

Профиль состава эпитаксиальных слоев по направлению роста [001] определялся методом ВИМС (рис. 2), для калибровки использовались данные измерений с помощью рентгеновского микроанализатора "Camebax". Составы слоев GaInAsP образцов № 1-4, полученных в настоящей работе, показаны на рис. 1.

Исследование структуры эпитаксиальных слоев проводилось на базе трехкристального рентгеновского спектрометра с использованием симметричных рефлексов типа (004) в $\operatorname{Cu}K_{a1}$ -излучении, измерялось рассогласование слоя и подложки ($\Delta a/a$)_{\perp} = $(a_{\operatorname{GaInAsP}_{\perp}} - a_{\operatorname{InP}_{\perp}})/a_{\operatorname{InP}_{\perp}}$ по направлению [001]. Здесь $a_{\operatorname{InP}_{\perp}}$ и $a_{\operatorname{GaInAsP}_{\perp}}$ — параметры решетки подложки и слоя по направлению [001]. Кривые рентгеновской дифракции представлены на рис. 3.

Согласно данным ВИМС, содержание элементов третьей группы *x* в полученных слоях $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ оставалось практически постоянным по толщине эпитаксиального слоя (рис. 2, *a*). Содержание элементов пятой группы изменялось по всей толщине на величину Δy (рис. 2, *b*). У образцов № 1–3 содержание мышьяка *y* монотонно возрастало от гетерограницы с InP к поверхности структуры (рис. 2, *b*, кривые 1-3), у образца № 4 содержание мышьяка возрастало к середине слоя, после чего снова начинало уменьшаться (рис. 2, *b*, кривая 4). Размытие гетерограницы на профиле ВИМС Δh мы определили по участку, на котором при переходе от InP к GaInAsP



Рис. 1. Фрагмент концентрационного квадрата $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ с изоэнергетическими линиями, линией изопериода с InP (LM to InP) и составами эпитаксиальных слоев образцов № 1–4, полученных в настоящей работе. Стрелками показано направление изменения состава от гетерограницы с InP к поверхности слоя.

монотонно изменяется содержание элементов третьей группы. Толщина этого участка определялась по так называемому критерию 84%-16%, что соответствует разности координат по глубине при изменении концентрации матричного элемента на границе раздела от 16 до 84% от их номинальных значений. В том случае, когда $\Delta h < 15$ nm, размытие гетерограницы на профиле ВИМС мы связываем с разрешением по толщине. Для образца № 1 $\Delta h = 40$ nm, для образца № 2 $\Delta h = 30$ nm, причем на снимках скола и поверхности, сделанных при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), не наблюдается рельефа, более существенного, чем у образцов № 3, 4 с $\Delta h < 15$ nm. Вероятно, большая величина Δh для образцов № 1, 2 связана с образованием



Рис. 2. Профиль ВИМС с рассчитанным по толщине значением $(\Delta a/a)_{calc}$ (без учета деформации) для структуры № 2 (*a*) и изменение содержания мышьяка по толщине структур № 1–4 (*b*). Номера кривых на части *b* соответствуют номерам образцов. *h* — расстояние от поверхности эпитаксиального слоя по направлению [001].



Рис. 3. Кривые рентгеновского дифракционного отражения для образцов № 3 и 4. θ — брэгговский угол отражения от структуры, θ_{InP} — брэгговский угол отражения от InP.

переходного слоя, в котором имеется градиент содержания элементов третьей группы *x*.

Непостоянство содержания элементов пятой группы по толщине всего эпитаксиального слоя $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ приводит к уширению кривых рентгеновского дифракционного отражения, что ярко выражено у образца № 3 с изменением содержания элементов пятой группы в слое $Ga_{1-x}In_xAs_yP_{1-y}$ на величину $\Delta y = 0.08$ (рис. 3). Согласно данным ВИМС, увеличение параметра решетки у образцов № 1–3 происходит от гетерограницы к поверхности, поскольку в этом направлении увеличивается содержание мышьяка *y*, имеющего ковалентный атомный радиус, больший, чем у фосфора. Для образца № 3 при удалении от гетерограницы с InP $|(\Delta a/a)_{\perp}|$ увеличивается. Для образцов № 1 и 2 значение $|(\Delta a/a)_{\perp}|$ максимально у границы с InP и уменьшается к поверхности (рис. 2, *a*). Аналогичная ситуация наблюдалась нами в [7] для InAsPSb на InAs. У образца № 4 содержание мышьяка *y*

изменялось немонотонно (рис. 1, *b*). Вероятно, это связано с тем, что состав газовой смеси при получении этого образца был близок к необходимому для формирования твердого раствора, согласованного с InP на начальном этапе роста, а немонотонное изменение *у* может быть связано с характером упругих деформаций, возникающих в слое за счет того, что при температуре роста $(\Delta a/a)_{\perp} \neq 0$. О том, что на встраивание компонентов пятой группы в кристаллическую решетку влияет деформация растущего слоя, также свидетельствуют данные работы [8], в которой исследовались условия роста GaAsP на GaAs при молекулярно-пучковой эпитаксии.

Обобщая данные [5–8] и настоящей работы, можно сделать вывод, что изменение состава по толщине эпитаксиального слоя возможно во всех твердых растворах, в которые входит более одного химического элемента пятой группы. Данные выводы согласуются с упомянутыми в литературе явлениями неоднородного распределения элементов пятой группы по площади эпитаксиальной структуры [2,4]. Полученные в настоящей работе результаты будут полезны для оптимизации режимов эпитаксиального выращивания и трактовки экспериментальных результатов.

Авторы выражают глубокую благодарность коллеге из ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН С.И. Трошкову за снимки сколов и поверхностей образцов, сделанные при помощи СЭМ.

Исследования ВИМС, СЭМ, а также измерения с помощью рентгеновского микроанализатора "Сатевах" проводились с использованием оборудования ЦКП "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях" (ФТИ им. А.Ф. Иоффе), поддерживаемого Министерством образования и науки (уникальный идентификатор проекта RFMEFI62117X0018).

Список литературы

- Vurgaftman I., Meyer J.R., Ram-Mohan L.R. // J. Appl. Phys. 2001. V. 89. P. 5815–5875.
- [2] Razeghi M. MOCVD challenge. Survey of GaInAsP–InP & GaInAsP–GaAs for photonic and electronic device applications. 2nd ed. Taylor and Francis/CRC Press, 2010. 773 p.
- [3] Lei P.-H. // Opt. Commun. 2007. V. 273. P. 532–537.

- [4] Holstein W.L. // J. Cryst. Growth. 1996. V. 167. P. 525-533.
- [5] Романов В.В., Байдакова М.В., Моисеев К.Д. // ФТП. 2014. Т. 48. В. 6. С. 753– 758.
- [6] Моисеев К.Д., Романов В.В., Кудрявцев Ю.А. // ФТТ. 2016. Т. 58. В. 11. С. 2203–2207.
- [7] Васильев В.И., Гагис Г.С., Левин Р.В., Кучинский В.И., Дерягин А.Г., Казанцев Д.Ю., Бер Б.Я. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. В. 19. С. 78–86.
- [8] Cunningham J.E., Santos M.B., Goossen K.W., Williams M.D., Jan W. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64. P. 2418–2420.